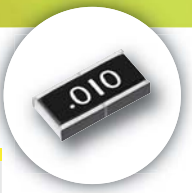
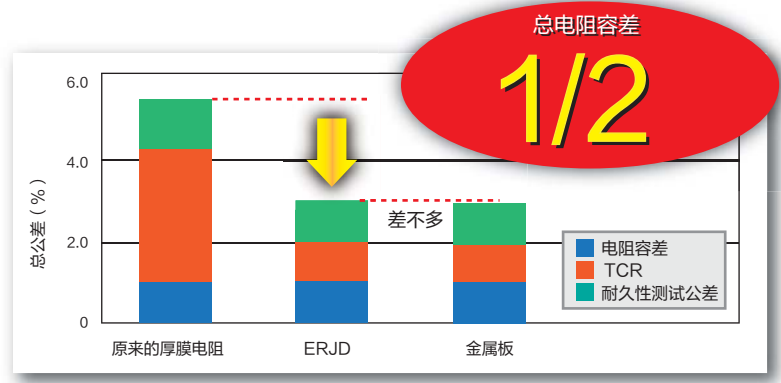


ERJD 系列



通过厚膜实现低电阻和低TCR的产品
~可换金属板~



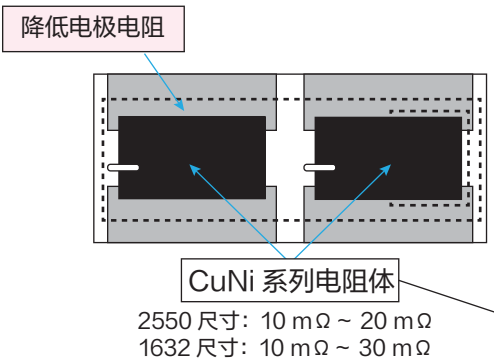
[以10 mΩ实现TCR 350 → 100 ppm / °C]

与金属板相同的性能

1. 确保平台的设计余量
2. 提高了平台的性能可靠性
3. 降低成本



以独特的电阻材料降低低电阻TCR



- 通过在低电阻 (10 mΩ 至 200 mΩ) 的电阻上限范围内使用AgPd电阻体, 在较低电阻范围内使用CuNi电阻体, 可降低低电阻TCR
- 在10 mΩ 以上实现与金属板电流检测电阻相同的低TCR

规格

型号	尺寸 (mm)	额定功率 (W)	耐受性 (%)	电阻值范围 (Ω)	TCR (x10 ⁻⁶ / °C)	类别温度范围 (°C)
ERJD1	2550	2.0	± 1, ± 5	10 m ~ 200 m	± 100	-55 ~ 155
ERJD2	1632	1.0	± 1, ± 5	10 m ~ 200 m	± 100	

详情请参考敝司网页!

